

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 24 年 1 月 5 日 (2012.1.5)

【公開番号】特開 2011-119548 (P2011-119548A)
 【公開日】平成 23 年 6 月 16 日 (2011.6.16)
 【年通号数】公開・登録公報 2011-024
 【出願番号】特願 2009-276906 (P2009-276906)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 21/301 (2006.01)

C 0 9 J 7/02 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/78 M

H 0 1 L 21/78 Q

H 0 1 L 21/78 B

C 0 9 J 7/02 Z

【手続補正書】
 【提出日】平成 23 年 11 月 15 日 (2011.11.15)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 0 5 8
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【0 0 5 8】

< チップ分割率 >

上記のステルスダイシング条件で、シリコンウエハの内部に改質部を形成し、ウエハと 8 インチウエハ用リングフレームとを実施例又は比較例の粘着シートに貼付後、エキスパンド装置（ディスコ社製、D D S 2 0 1 0）を用いて、粘着シートをエキスパンドし、ウエハをチップ化した。なお、カットチップサイズが 2 mm × 2 mm のものは、粘着シートをエキスパンド（3 0 0 mm / 分で 1 0 mm 引き落とし）してウエハをチップ化し、カットチップサイズが 0 . 5 mm × 0 . 5 mm 及び 0 . 1 5 mm × 0 . 1 5 mm のものは、エキスパンド（3 0 0 mm / 分で 5 mm 引き落とし）と同時に粘着シートを基材側から治具を用いてひっかいて、ウエハをチップ化した。カットチップサイズにチップ化されたチップの数（完全に個片化されたチップの数）を目視にて数え、ウエハ上に想定された全チップ数（仮想チップの合計数）に対するチップ分割率を算出した。チップ分割率が 9 9 . 5 % 以上の場合を「非常に良好」、9 8 % 以上を「良好」、9 8 % 未満を「不良」とした。また、粘着シートの粘着剤層にエネルギー線硬化型の粘着剤層を用いる場合は、エネルギー線照射前に粘着シートをエキスパンドした。